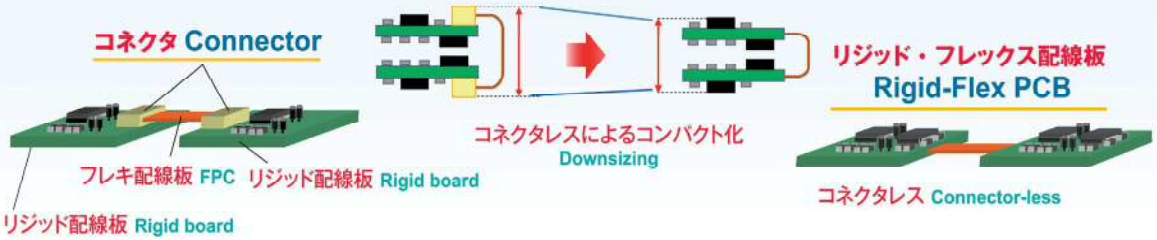
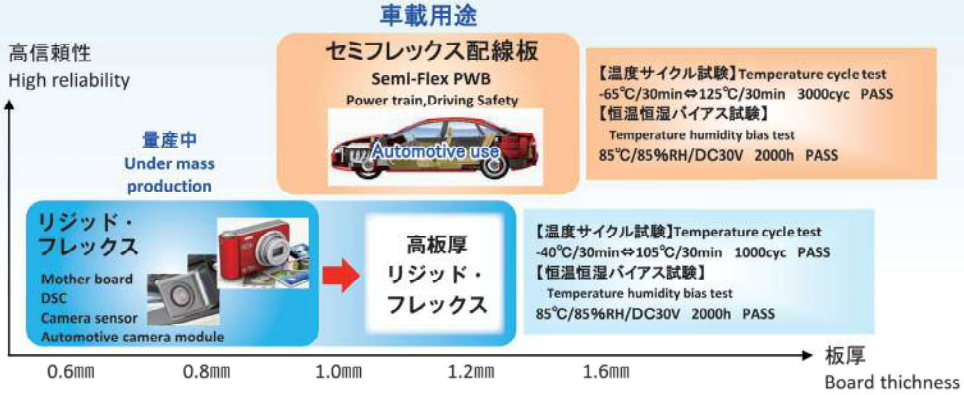
屈曲　省スペース　モジュール

Rigid-Flex Series
コネクタレス、基板屈曲によるコンパクト化

実装工数低減、コンパクト化、ノイズ低減　Costreduction,Downsizing,Noisereduction



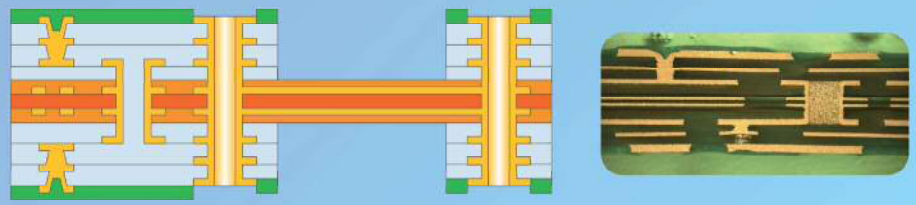
豊富なラインナップ　Various line up



バリエーション　Variation

リジッド・フレックス　豊富なバリエーションで様々なニーズに対応

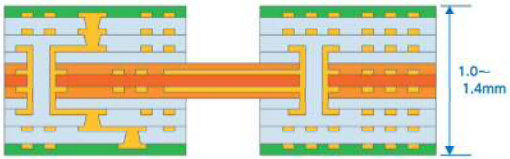
2段ビルドアップ　8layer　t=～0.95mm



■ 高板厚リジッド・フレックス　Thick RF
“リジッド・フレックス配線板にしたいが、板厚も欲しい”
※適用板厚 thickness　：　1.0 ＜ t ≦ 1.4mm

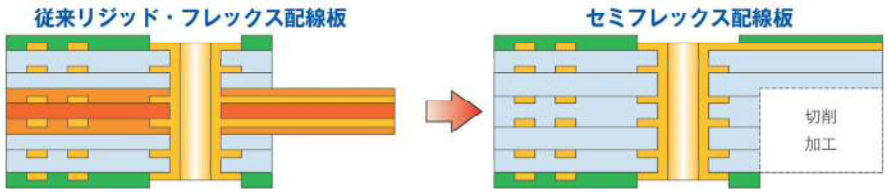
【温度サイクル試験】Temperature cycle test
－40℃／30min⇔105℃／30min　1000cyc　OK

2段ビルドアップ　8layer



セミフレックス　屈曲させたまま組み立てる構造の車載機器向けにも対応

構造　Structure



従来リジッド・フレックスとの比較

		リジッド・フレックス	セミフレックス
板厚	・車載用途の厚板対応（～1.6mm）	×	○
導通信頼性	・温度サイクル試験　3000c. −65℃（30min）⇔125℃（30min）	×	○
絶縁信頼性	・高温高湿バイアス試験 1000h 85℃/85%/DC30V	○	○
折り曲げ性	屈曲サイクル試験 R5	○	△